

BEGO Implant Systems unterstützt Doppel-Olympiasieger

„Go for Gold“ und „Miteinander zum Erfolg“, das passt auch zum neuen Sport-Sponsoring der BEGO Implant Systems GmbH & Co.KG. Mit dem Zahnarzt, Oralchirurgen und Doppel-Olympiasieger *Hinrich Romeike*, Rendsburg konnte die BEGO Implant Systems einen mehrjährigen Sponsorvertrag unterzeichnen. Über das Volumen des Vertrags haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. BEGO Implant Systems wird mit seinem langjährigen Anwender der BEGO Semados Implantate in einer Anzeigenkampagne werben. Darüber hinaus sind weitere Preseterminale und Autogramstunden geplant. Herr *Romeike* unterstützte BEGO erstmals bei der DGI-Jahrestagung in Frankfurt am Messestand.



Das BEGO-Team freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht *Hinrich Romeike* als BEGO-Anwender und erfolgreicher Reiter weiterhin viel Erfolg.

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

Maike Wachendorf
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst Straße 1, 28359 Bremen
Tel.: 04 21 / 20 28 – 267, Fax: 04 21 / 20 28 – 265
www.bego-implantology.com, wachendorf@bego.com,



Gute Konusdichtigkeit – durch Präzision

Das ICX templant überzeugt durch die bewährte ICX templant-Oberfläche. Die Aufbauten des ICX-Systems verfügen über einen bewährten tiefen Konus. Diese Konuskonstruktion bietet Sicherheit und vereinfacht das prothetische Handling. Das „Platform-Switching“ des ICX templant ist unserer Meinung nach, ein wichtiger Faktor für die langfristige Gewebestabilität. Die konische, form- und kraftschlüssige ICX-Verbindung ist stabil und schließt Mikrobewegungen so gut wie aus. Sie ist eine nahezu bakteriendichte Implantat-Abutment-Verbindung. Unserer Meinung nach bedeutet dies, dass durch eine konische und nahezu bakteriendichte Verbindung der Knochenabbau vermieden und das Weichgewebe langfristig stabilisiert wird.

medentis medical GmbH

Gartenstraße 12
53507 Dernau
Tel.: 0 26 43 / 90 20 00 – 0
Fax: 0 26 43 / 90 20 00 – 20
www.templant.de, info@medentis.de

Mini-Mix Gun – Applikation von Stiftaufbauten

Mit dem Composite DentinBuild, dem Adhäsivsystem DentinBond und dem Wurzelstift DentinPost Coated bietet das Unternehmen ein vollständiges Stiftaufbausystem an. DentinBuild ist ein fiberglasverstärktes, dualhärtendes Composite. Mit der neuen DentinBuild Mini-Mix Gun kann das Composite, das sich zur Befestigung des Wurzelstiftes und zum Stumpfaufbau eignet, leichter aus der Mini-Mix Spritze gedrückt werden: Einfach den vorderen und hinteren Teil der Mini-Mix Spritze auseinander ziehen und den vorderen Teil der Spritze in die vorgesehene Öffnung der Pistole stecken. Auch zum zahnfarbenen DentinPost Coated gehört ein Handlingteil, das nach Einsetzen durch leichtes Verkanten abgeknickt wird. Dadurch entstehen apikal bis koronal erstmals identische Grenzflächen zwischen Wurzelstift und Composite, die eine gute Verbundfestigkeit ermöglichen.



Gebr. Brasseler GmbH & Co KG

Trophagener Weg 25
32631 Lemgo
Tel.: 0 52 61 / 701 – 0
Fax: 0 52 61 / 701 – 289
www.kometdental.de
info@brasseler.de

Rebilda Post-Wurzelstifte

Mit dem glasfaserverstärkten Composite-Wurzelstift Rebilda Post ergänzt Voco das dualhärtende Stumpfaufbau- und Befestigungsmaterial Rebilda DC. Der besonders röntgenopake, transluzente Rebilda Post mit dentinähnlichem Elastizitätsverhalten führt zu einer dauerhaften und ästhetisch hochwertigen, metallfreien Restauration. Rebilda Post ist Bestandteil eines aufeinander abgestimmten Stift-Aufbau-Systems (Rebilda DC, Futurabond DC, Ceramic Bond, Zubehör). Wie das Stumpfaufbaumaterial Rebilda DC besteht der neue Wurzelstift aus einer Dimethacrylat-Matrix, sodass ein zuverlässiger Verbund unter Aufbau eines stabilen Monoblocks erzielt wird. Rebilda Post ist mit den zugehörigen Bohrern sowohl im Rahmen eines Wurzelstift-Intro-Sets als auch eines kompletten Angebots zur postendodontischen Versorgung erhältlich.



VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1 – 3
27472 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21 / 719 – 0
Fax: 0 47 21 / 719 – 140
www.voco.de, info@voco.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.